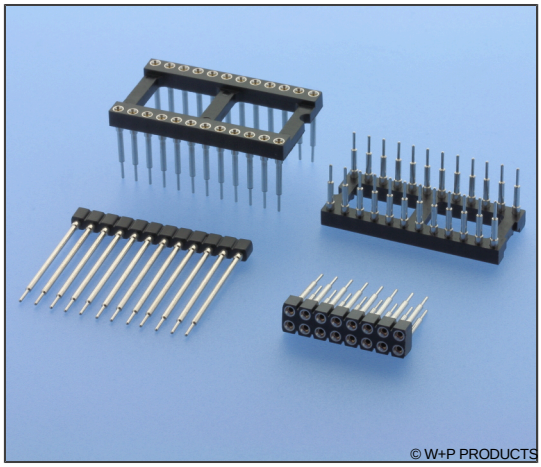
174 / 187

Abgesetzte IC-Fassungen / IC-Leisten RM 2,54mm - Bauhöhen 6,0–35,0mm

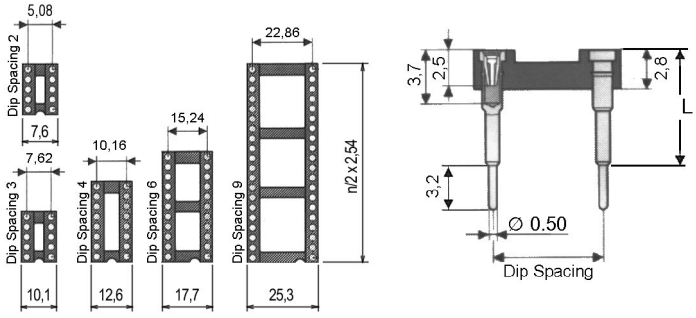
Lifted IC Sockets / IC Headers 2.54mm Pitch – 6.0–35.0mm Profile

Technische Daten / ***Technical Data***

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	*Thermoplastic, rated UL94 V-0*
Kontaktmaterial	Hülse: Messing gedreht Feder: 4-Lamellen-Clip, Beryllium-Kupfer
Contact Material	*Sleeve: screw machined brass* *Clip: 4-Finger-Clip, Beryllium-Copper*
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni
Contact Surface	*Acc. to options (see below), over Ni*
RoHS-Ausnahmen 6a-I / 6c	6c; ohne RoHS-Ausnahme mit Option -LF21
RoHS Exemptions 6a-I / 6c	*6c; Option -LF21 w/o RoHS-Exemption*
Durchgangswiderstand	< 10 mΩ
Contact Resistance	*< 10 mΩ*
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
Insulation Resistance	*> 1000 MΩ*
Spannungsfestigkeit	1 kV RMS
Withstanding Voltage	*1 kV RMS*
Nennspannung	100 V RMS / 150 V DC
Voltage Rating	*100 V RMS / 150 V DC*
Nennstrom	1 A
Current Rating	*1 A*
Temperaturbereich	-55 °C ... +125 °C
Temperature Range	*-55 °C ... +125 °C*
Verarbeitung	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren
Processing	*Wave or reflow soldering*

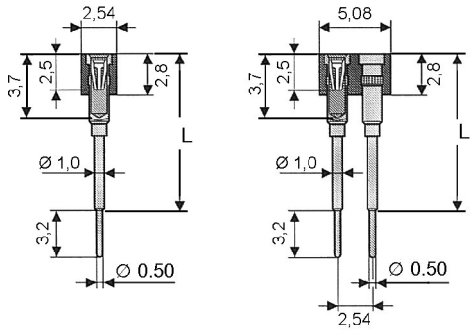


Für Rundstifte Ø0,40-0,56mm
oder Vierkantstifte 0,25x0,45mm.
For Ø0.40-0.56mm round pins
or 0.25x0.45mm rectangular pins.



Terminal*

10 L=6,0mm
20 L=8,0mm
30 L=10,2mm
40 L=12,0mm
45 L=13,5mm
50 L=15,1mm
60 L=18,0mm
70 L=22,0mm
80 L=29,0mm
90 L=35,0mm



n	DIP (Code)	DIP [mm]
10	2	5.08
06-24	3	7.62
28		
20-24	4	10.16
28		
32		
10	6	15.24
24		
28		
32		
36		
40/42		
48-52		
50/52	9	22.86
64		

Series

174

174 IC-Fassung
IC-Socket

Contacts*

174

06-24/28/32/36/40/42/48/50/52/64
DIP Spacing Optionen entspr. Tabelle
DIP Spacing options pl. see table

DIP-Spacing*

174

2 5,08mm
3 7,62mm
4 10,16mm
6 15,24mm
9 22,86mm

Terminal*

174

10-90 s. Tabelle
acc. table

Sleeve Plating

174

50 Verzinnt
Tin plated

Clip Plating*

174

10 Au 0.25µm
30 Au 0.75µm

Leadfree (Optional)*

174

LF21 Auf Anfrage bleifrei ohne RoHS Ausnahme 6c
On request leadfree without RoHS exemption 6c

Series

187

187 IC-Leisten
IC Headers

Contacts*

187

01-64 Einreihig
Single row
02-64 Zweireihig
Double row

Rows*

187

1 Einreihig
Single row
2 Zweireihig
Double row

Terminal*

187

10-90 s. Tabelle
acc. table

Sleeve Plating

187

50 Verzinnt
Tin plated

Clip Plating*

187

00 Au flash
10 Au 0.25µm (Option)

Leadfree (Optional)*

187

LF21 Auf Anfrage bleifrei ohne RoHS Ausnahme 6c
On request leadfree without RoHS exemption 6c

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
** This is an **order example** -*
please replace by your specifications.

Informationen zum Reflow-Lötverfahren
Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_S$min	150 °C
Temperatur Maximum $T_S$max	200 °C
Dauer $T_S$min – $T_S$max	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	217 °C
Verweildauer oberhalb T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_S$max – T_P	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_P$max – $T_S$min	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_S$min	*150 °C*
Maximum Temperatur $T_S$max	*200 °C*
Duration $T_S$min – $T_S$max	*60 – 180s*
Soldering Range Temperature T_L	*217 °C*
Duration above T_L	*60 – 180s*
Ramp-Up Rate $T_S$max – T_P	*max. 3 °C / s*
Peak Temperature T_P	*260±5 °C*
Duration Peak Temperature	*20 – 40s*
Ramp-Down Rate $T_P$max – $T_S$min	*6 °C / s*
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	*max. 8min*

